

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局(43)国際公開日
2005年8月4日 (04.08.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/071489 A1(51)国際特許分類⁷: G03F 7/027

(21)国際出願番号: PCT/JP2005/000761

(22)国際出願日: 2005年1月21日 (21.01.2005)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:
特願2004-016751 2004年1月26日 (26.01.2004) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本化薬株式会社 (NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1028172 東京都千代田区富士見一丁目11番2号 Tokyo (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 小柳 敬夫 (KOYANAGI, Hiroo) [JP/JP]; 〒1750092 東京都板橋区赤塚3-31-9 Tokyo (JP). 田中 竜太朗 (TANAKA, Ryutaro) [JP/JP]; 〒1150042 東京都北区志茂3-33-5 ブラザ赤羽101号 Tokyo (JP). 魁谷 英照 (KAMETANI, Hideaki) [JP/JP]; 〒1150042 東京都北区志茂4-31-11 Tokyo (JP).

(74)代理人: 川口 義雄, 外 (KAWAGUCHI, Yoshio et al.); 〒1600022 東京都新宿区新宿1丁目1番11号 友泉新宿御苑ビル 川口國際特許事務所 Tokyo (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

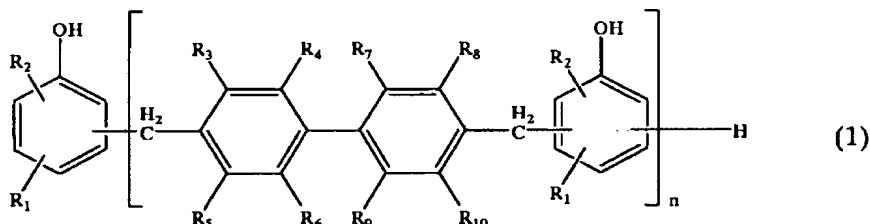
(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

(54)Title: PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND CURED PRODUCT THEREOF

(54)発明の名称: 感光性樹脂組成物及びその硬化物



WO 2005/071489 A1

(57) Abstract: [PROBLEMS] Disclosed is a photosensitive resin composition with excellent photosensitivity whose cured product is excellent in adhesiveness, pencil hardness, solvent resistance, acid resistance, heat resistance, gold plating resistance, HAST properties, flame retardance, flexibility and the like. Also disclosed is such a cured product. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] A photosensitive resin composition is characterized by comprising a reaction product (A) of a compound (a) represented by the formula (1) below, a compound (b) having an ethylenically unsaturated group and a glycidyl group in a molecule and a polybasic acid anhydride (c), a crosslinking agent (B) and a photopolymerization initiator (C). (1) (In the formula, n represents an average value between 1-20, R₁ and R₂ may be the same or different and respectively represent a hydrogen atom, a halogen atom or a C₁-C₄ lower alkyl group; R₃, R₅, R₈ and R₁₀ may be the same or different and respectively represent a hydrogen atom, a halogen atom or a methyl group; and R₄, R₆, R₇ and R₉ may be the same or different and respectively represent a hydrogen atom or a methyl group.) Also disclosed is a cured product of such a photosensitive resin composition.

/統葉有/